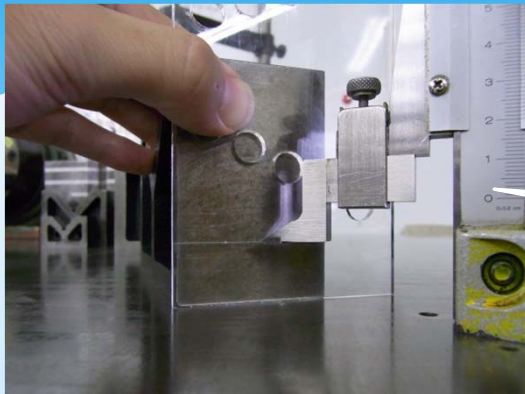


レーザー加工機 デモンストレーション

実験教育支援センター
機械系共通実習室
吉田 久展

はじめに (従来の加工方法)



1. 野書き作業



2. 粗取り作業
(帯鋸盤)



3. 整形作業
(フライス盤)

※必要に応じて
4. 穴あけ作業 (ボール盤)



完成！！

特 徴

利 点

- 薄物樹脂加工に最適（アクリル、PET板、木材など）
- 短時間で行える
1. 罫書き → 2. 帯鋸 → 3. フライス盤 → 4. ボール盤



1. 作図 → 2. レーザー加工機へ出力

- 切り屑が出ない
- 加工者の作業負荷が従来加工法より大幅に軽減

欠 点

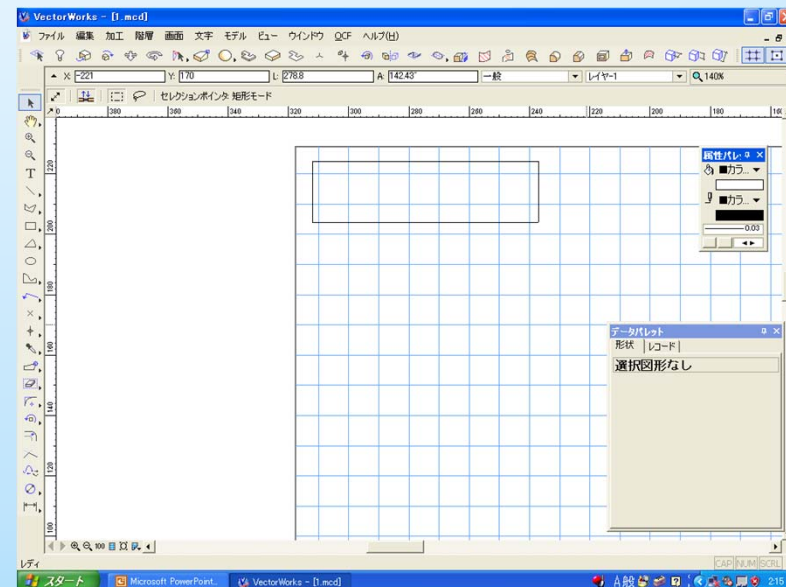
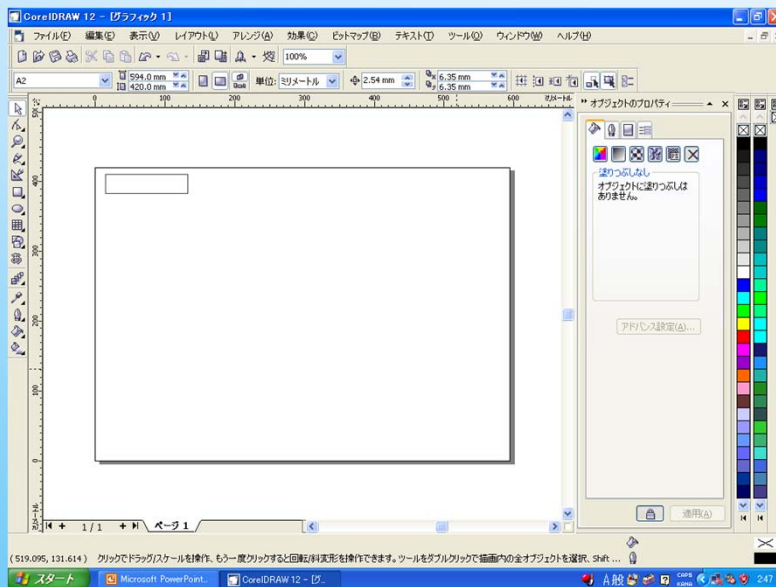
- 出力が小さいため加工できる板厚は、8mm以下
- 加工精度は、1/10mm程度
- 加工時に排気ガスが出る



操作方法

1.加工する形状の作図

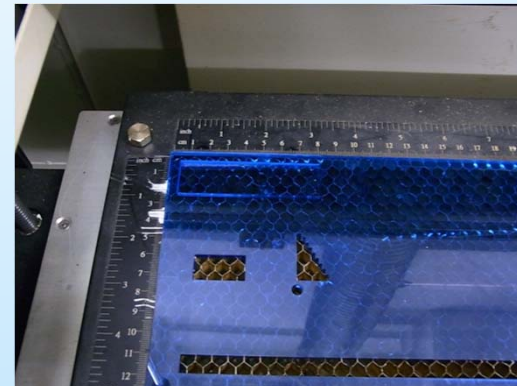
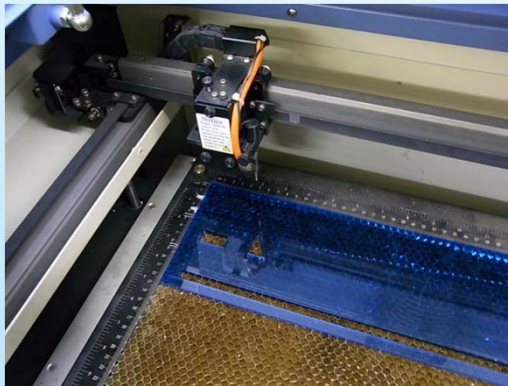
- CAD(ベクターワークス)・編集ソフト(CorelDRAW)を用いて、必要な形状を作図する



操作方法

2.加工部品の製作

- 本体に使用する材料をセットし、レーザーの焦点を合わせる(オートフォーカス)
- 出来上がった図面のデータをMarkyurry(レーザー加工機)を選択して出力



完 成

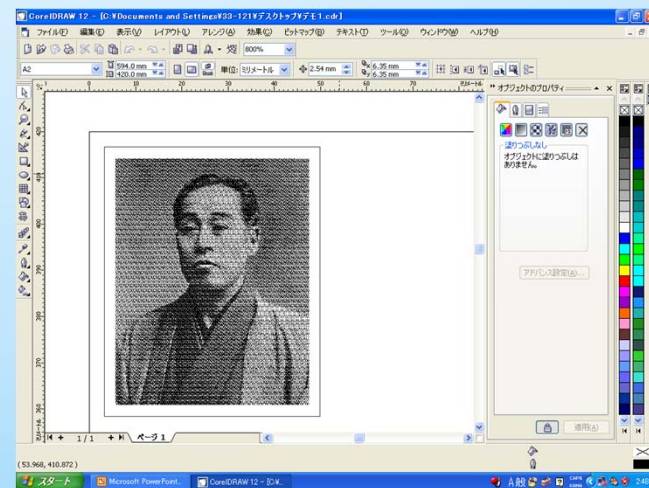


デモンストレーション

1.材料のカット 外形の製作および穴あけ

通常学生が使う作業

2.画像の彫刻



操高性能機種

